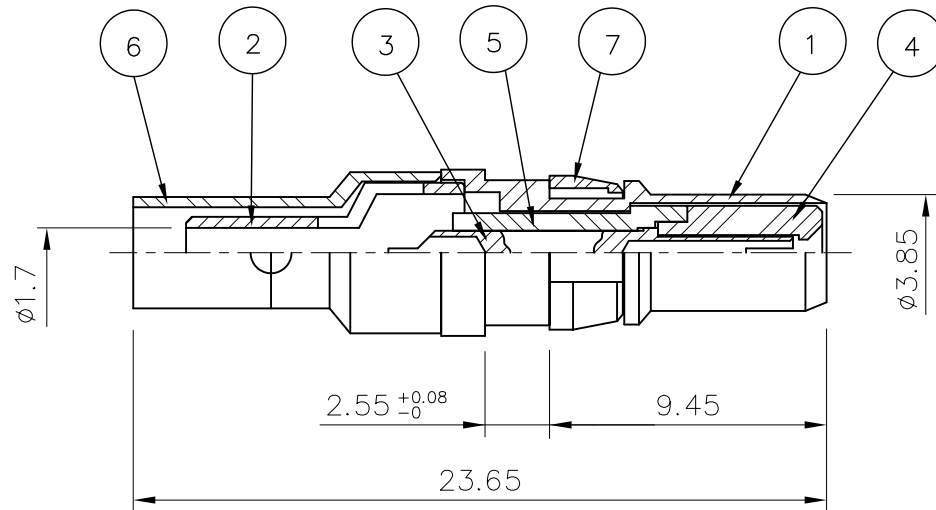


수 정 내 용										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
가공														
ST(기준)										△				
ST(개선)										△				



7	Ring	1	BeCu	Gold Plate	DSR00031-1345/1 (RB001)
6	Pipe	1	MBsBD	Gold Plate	DFE00014-1345/1 (FB001)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00905-N/1 (HB004)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00904-N/1 (HB003)
3	JACK PIN	1	BeCu	Gold Plate	DCT00954-1345/1 (EB002)
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01171-135/1 (DB002)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBT00007-135/1 (DB001)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일		1992. 7. 10.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD. 도명 KJD-P50-6		
	승인						
재질	감도			도명 KJD-P50-6			
	재도						
열처리	작성부서		연 구 소		도번 CN00641-7/1		
보호피막처리	적도 NS	단위 mm	총량	A4 K385-042-000			